

## 微电子学院“本科荣誉项目”实施方案

据复旦大学校长办公会议决议（校发文 [2015]165 号），遵照《复旦大学“本科荣誉项目”实施总则（试行）》（2016 年 9 月 20 日制定）的原则，特制订如下微电子学院“本科荣誉项目”实施方案：

1. 实施对象：微电子科学与工程专业 2019 级全体本科生；
2. 学生申请本院系“荣誉证书”的条件：
  - 1) 符合复旦大学学士学位授予标准，德才兼备；
  - 2) 满足微电子科学与工程专业“2+X”培养方案中要求的修读完两个专业进阶模块；
  - 3) 修读微电子学院荣誉课程的学分数不低于 24 分，课程门数不少于 5 门；表中所列的 10 门荣誉课程，其中半导体物理(H)、数字集成电路设计原理(H)、集成电路工艺原理(H)三门课程为荣誉必修课程；荣誉课程成绩平均绩点要求为 3.5 以上；要求修读的总学分数不低于 154 学分；

表：微电子学院荣誉课程

开课学期	二年级 上学期	二年级 下学期	三年级 上学期	三年级 下学期	四年级 上学期
荣誉课程	数字逻辑基础(H)	半导体物理(H) 数据与算法结构(H)	半导体器件原理(H) 数字集成电路设计原理(H) 嵌入式处理器与芯片系统设计(H)	集成电路工艺原理(H) 模拟集成电路设计原理(H) FPGA 结构原理和应用(H)	电子材料薄膜测试表征方法(H)

- 4) 本科期间所有课程平均绩点要求为 3.4 以上，专业课程成绩平均绩点要求为 3.5 以上；
  - 5) 参与一定的科研实践，具体要求为：在教授研究组里开展科研工作一年以上，需主持一项“箬政”、“望道”、“曦源”、“登辉”项目并结题，申请“荣誉证书”时需教授提供科研项目完成情况的评价说明；毕业论文必须取得 A 或 A-成绩；
3. 申请人本科毕业时若达到上述条件，可向院系教学指导委员会申请“荣誉证书”

书”；修读了部分荣誉课程但未达到“荣誉证书”标准的，可按照本系荣誉课程的学分替代原则正常申请相应专业的学士学位。

**备注：**

1. 荣誉课程采用小班教学，每班一般不超过 30 个学生，任课教师可以设定入选标准。

2. 荣誉课程的成绩由两部分组成，包括‘基础部分’成绩和‘加深拓展’成绩：  
‘荣誉课程’成绩 = ‘基础部分’成绩 × 70% + ‘加深拓展’成绩 × 30%，其中‘基础部分’成绩是对普通大班学习情况的考查，‘加深拓展’成绩是对参与普通大班学习之外的讨论班参与情况、Project、Presentation 等完成情况的考查。‘加深拓展’成绩评定 A 类比例不设上限。参与荣誉课程的学生将以‘荣誉课程’成绩与普通大班中的学生一起评定最后成绩，荣誉课程学生和普通大班学生获 A 类成绩的总比例不得超过全部学生人数的 40%。‘基础部分’与‘加深拓展’所占比例可因课程不同而调整，具体参见相应荣誉课程的教学大纲。

3. 荣誉课程的深度和广度显著超过普通大班课程，允许学生在第 3 周至第 14 周之间的任何时候，网上申请退出荣誉课程。

4. 荣誉课程的学分全额计入总学分，并可按本实施方案制订的课程替代方案进行学分转换与认定，但学分转换与认定只作为本科毕业资格审核的依据，成绩单则如实记载学生所修课程与成绩，不作变更。

5. 学生修读荣誉课程的学分如超过替换课程的学分，可转换成专业进阶课程（≤3 学分）和任意选修课程学分，按实际成绩计算绩点。

附：微电子学院荣誉课程替换方案

课程代码	课程名称	学分/ 周学时	实验 (含上机) 学分	实践 学分	实验 实践 学分 合计	开课 学期	课程负 责教师	课程特色描述	可替换课程及 相应学分
MICR130003h	数字逻辑基础 (H)	6/6	2.0	0	2.0	3	易婷	■深度加强 □小班授课的研讨式课程 ■大班授课增加小班讨论课时 □增加阅读量 □外教参与建设 □重新编写教材 □其它：	MICR130003 数字逻辑基础 (4 学分)
MICR130005h	半导体物理 (H)	6/6	0	0	0	4	蒋玉龙	■深度加强 □小班授课的研讨式课程 ■大班授课增加小班讨论课时 □增加阅读量 □外教参与建设 □重新编写教材 □其它：	MICR130005 半导体物理 (4 学分)
MICR130009h	数据结构与算 法(H)	6/6	2.0	0	2.0	4	严昌浩	■深度加强 □小班授课的研讨式课程 ■大班授课增加小班讨论课时 □增加阅读量 □外教参与建设 □重新编写教材 □其它：	MICR130009 数据结构与算法 (4 学分)
MICR130028h	半导体器件原 理(H)	6/6	0	0	0	5	蒋玉龙	■深度加强 □小班授课的研讨式课程 ■大班授课增加小班讨论课时 □增加阅读量 □外教参与建设 □重新编写教材 □其它：	MICR130028 半导体器件原理 (4 学分)
MICR130029h	数字集成电路 设计原理(H)	4/4	0	1.0	1.0	5	任俊彦	■深度加强 □小班授课的研讨式课程 ■大班授课增加小班讨论课时 □增加阅读量 □外教参与建设 □重新编写教材 □其它：	MICR130029 数字集成电路设计原理 (3 学分)
MICR130006h	嵌入式处理器 与芯片系统设 计(H)	6/6	2.0	0	2.0	5	韩军	■深度加强 □小班授课的研讨式课程 ■大班授课增加小班讨论课时 □增加阅读量 □外教参与建设 □重新编写教材 □其它：	MICR130006 嵌入式处理器与芯片系 统 (5 学分)

MICR130007h	集成电路工艺原理(H)	4/4	2.0	0	2.0	6	周嘉	■深度加强 □小班授课的研讨式课程 ■大班授课增加小班讨论课时 □增加阅读量 □外教参与建设 □重新编写教材 □其它：	MICR130007 集成电路工艺原理 (3 学分)
MICR130030h	模拟集成电路设计原理(H)	4/4	1.0	0	1.0	6	许俊	■深度加强 □小班授课的研讨式课程 ■大班授课增加小班讨论课时 □增加阅读量 □外教参与建设 □重新编写教材 □其它：	MICR130030 模拟集成电路设计原理 (3 学分)
MICR130024h	FPGA 结构原理和应用(H)	5/5	0	2.0	2.0	6	王伶俐	■深度加强 □小班授课的研讨式课程 ■大班授课增加小班讨论课时 □增加阅读量 □外教参与建设 □重新编写教材 □其它：	MICR130024 FPGA 结构原理和应用 (3 学分)
MICR130031h	电子材料薄膜测试表征方法(H)	3/3	1.0	0	1.0	7	卢红亮	■深度加强 □小班授课的研讨式课程 ■大班授课增加小班讨论课时 □增加阅读量 □外教参与建设 □重新编写教材 □其它：	MICR130031 电子材料薄膜测试表征方法 (2 学分)